

## 合肥新汇成微电子股份有限公司

### 关于 2024 年半年度营业收入情况的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，提高信息披露透明度，现将初步测算的 2024 年半年度营业收入情况进行自愿性披露。

#### 一、2024 年半年度营业收入情况

经公司财务部门初步测算，公司 2024 年上半年实现营业收入约 67,365.18 万元，较去年上半年同比增长约 20.90%；2024 年第二季度单季实现营业收入约 35,834.97 万元，较今年第一季度环比增长约 13.65%，较去年同期增长约 13.47%。

#### 二、营业收入变动的主要原因

2024 年上半年营业收入增长主要系公司产能持续扩充，下游应用领域景气度整体向好，部分品类终端需求相对旺盛，客户订单量与公司出货量有所增长。

公司专注于集成电路先进封装测试业务，所封测芯片类型主要聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司自 2023 年 6 月 16 日董事会审议通过可转债预案后，以自有或自筹资金先行投入可转债募投项目。可转债募投项目购置产线设备陆续转固投产，今年上半年公司产能较去年显著提升，叠加下游高清电视以及中小尺寸显示屏等应用领域景气度整体向好，公司营业收入实现同比增长。

### 三、相关风险提示

公司不存在影响本次自愿性披露内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载 2024 年半年度营业收入及变动幅度为公司初步测算数据，未经会计师事务所审计，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司净利润、扣除非经常性损益的净利润以及全年业绩情况，具体数据以公司定期报告中披露的数据为准，敬请投资者注意相关风险。公司已在《2023 年年度报告》当中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投资者查阅其中“风险因素”相关内容。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日